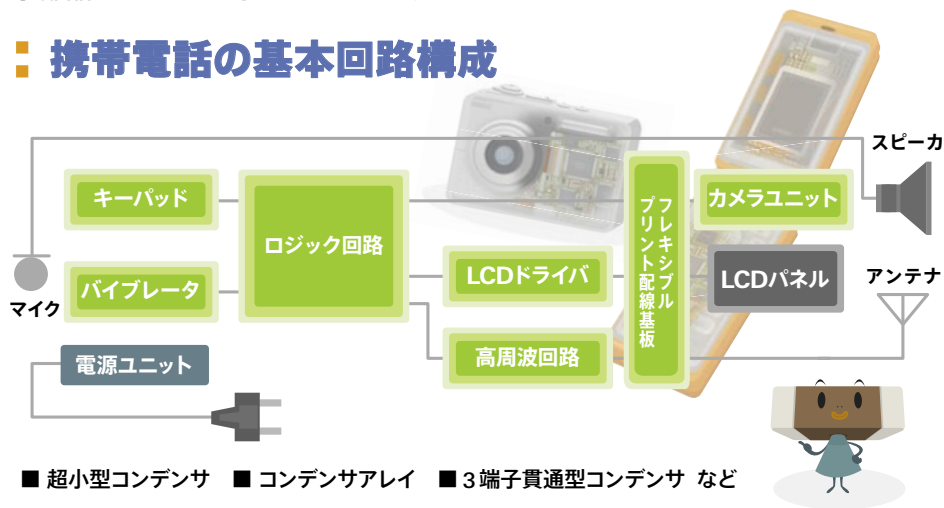


# 電子機器とコンデンサ② モバイル機器

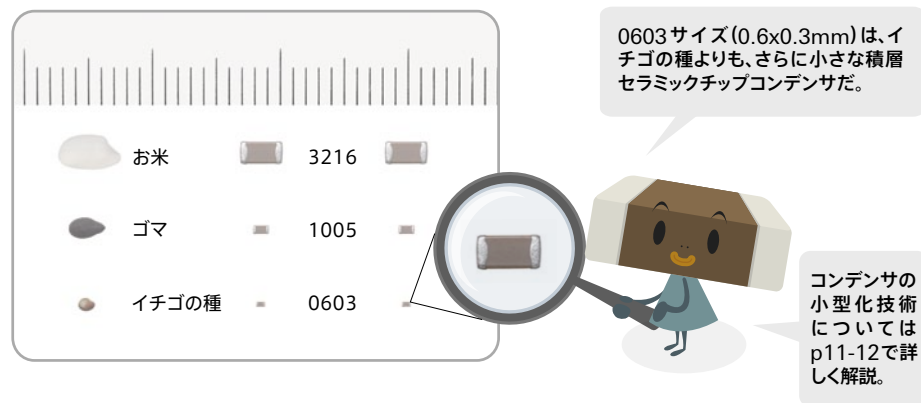
デジカメや電子マネー機能の搭載、ワンセグ放送の受信機能など、ますます多機能化する携帯電話。省電力化とともに、さらなる高密度実装を可能にする小型電子部品・デバイスが求められている。

## 携帯電話の基本回路構成

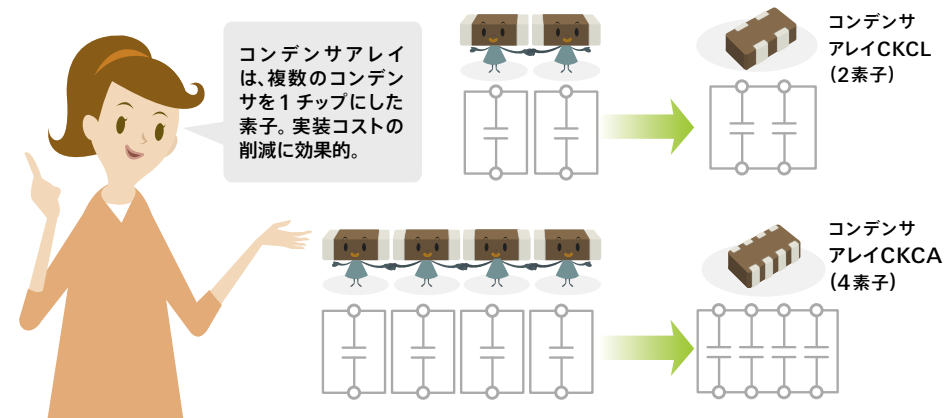


## 積層セラミックチップコンデンサの小型化トレンド

携帯電話などのモバイル機器には多数の積層セラミックチップコンデンサが使われる。現在の主流は 1005 サイズ (1.0×0.5mm) だが、これからは 0603 サイズ (0.6×0.3mm)、さらには超小型 0402 サイズ (0.4×0.2mm) へと移りつつある。



## コンデンサアレイ



## 低ESL 3端子貫通型コンデンサ モバイル機器に求められるノイズ対策

3端子貫通型コンデンサは従来とは異なる内部構造をもつ低ESLコンデンサだ。モバイル機器のノイズ対策部品として威力を発揮する。

